PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-273143

(43)Date of publication of application: 29.09.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/66 H01L 21/302

(21)Application number: 03-053507

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: WATABE HEIJI

MATSUI SHINJI

(54) MICROSCOPIC CROSS SECTION STRUCTURE OBSERVATION METHOD AND OBSERVATION DEVICE

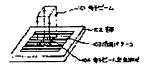
(57)Abstract:

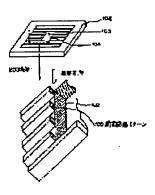
PURPOSE: To make it possible to observe the cross section of fine

27.02.1991

structure in any arbitrary region of a sample.

CONSTITUTION: A gas intake mechanism is additionally installed to a scanning type microscope so as to provide an etching performance by allowing a processed workpiece to adsorb active gas and emitting electron beam to the processed workpiece (electron beam excitation dry etching function). A sample to be observed is partially etched and eliminated by using this device so that the cross section may be exposed. Then, cross section observation in a fine region is carried out by tilting the sample. This construction makes it possible to observe the cross section in any fine region and to prepare a sample in the same vacuum tank continuously.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-273143

(43)公開日 平成4年(1992)9月29日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/66

N 7013-4M

庁内整理番号

21/302

D 7353-4M

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号

特廣平3-53507

(22) 出願日

平成3年(1991)2月27日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 渡部 平司

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 松井 真二

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 弁理士 舘野 千惠子

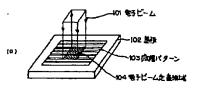
(54) 【発明の名称】 断面微細構造観察方法および観察装置

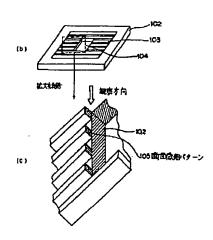
(57)【要約】

【目的】 微細構造の断面観察を試料中の任意の領域で 行うことができるようにする。

【構成】 走査型電子顕微鏡にガス導入機構を増設し、 被加工物に反応ガス吸着と電子線照射を行うことによる エッチング (電子ピーム励起ドライエッチング) 機能を 持たせる。この装置を用いて観察すべき試料の一部をエ ッチング除去して断面を露出させ、次いで試料を傾斜さ せて微小領域の断面観察を行う。

【効果】 任意の微小領域の断面観察ならびに試料の作 製を同一の真空槽内で連続して行うことができる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 試料表面上に反応ガスを吸着させた後、 電子線を照射する電子ピーム励起ドライエッチング法に より観察すべき試料の一部を除去して試料断面を露出さ せ、次いで該試料を傾斜して任意の領域の断面構造を電 子顕微鏡観察することを特徴とする断面微細構造観察方

【請求項2】 請求項1に記載の方法を実施するための 装置であって、走査型電子顕微鏡に、ガス導入機構と、 反応性ガス対応の差動排気システムと、試料を任意の傾 10 斜方向および傾斜角度で保持する試料台とを付設してな ることを特徴とする断面微細構造観察装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は断面微細構造観察方法お よび観察装置に関し、特に任意の領域の断面微細構造観 察が良好かつ簡単に行え、半導体製造工程および新機能 デバイスの作製に重要な微細加工技術の評価ならびにそ の観察に関する技術である。

[0002]

【従来の技術およびその課題】現在、微細加工技術にお いて、光や電子ピーム露光により形成した各種レジスト パターンならびに反応性イオンエッチングにより形成し た基板上の微細構造の断面観察は、試料を割ってその断 面を走査型電子顕微鏡などで観察している。図4は、こ の方法を工程順に示したもので、図4 (a) のように、 基板401に形成された微細パターン403を観察する ため、A-A[・]線でへき開して図4(b)のようにへき 開面404を酵呈させ、これを電子顕微鏡により図4 (c) のような、はく離405,破壊406,変形40 7等を観察する。しかしこの方法では、試料を割る際に 基板上の微細パターンがはく離したり破壊することがあ るので、実際には偶然にうまく割れた部分を探して観察 することになる。従って、観察すべき位置ならびに断面 の方向を任意に選べないという欠点がある。さらに基板 にへき開性のない場合やへき開面とずれた方向、および 微小な試料の観察の場合には試料の作製が困難である。 本発明はこのような従来の事情に対処してなされたもの で、任意の微小領域の断面観察を行うことの可能な観察 方法ならびに観察装置を提供することを目的とする。

[0003]

【課題を解決するための手段】本発明は、試料表面上に 反応ガスを吸着させた後、電子線を照射する電子ピーム 励起ドライエッチング法により観察すべき試料の一部を 除去して試料断面を露出させ、次いで該試料を傾斜して 任意の領域の断面構造を電子顕微鏡観察することを特徴 とする断面微細構造観察方法である。また上記の方法を 実施するための装置は、走査型電子顕微鏡に、ガス導入 機構と、反応性ガス対応の差動排気システムと、試料を 設してなることを特徴とする。電子ビーム励起ドライエ ッチングは異方性を有する低損傷の加工法であるため、 微細構造試料の任意の部分を簡単に除去することがで き、観察領域を自由に選ぶことが可能である。また断面 観察は加工後に試料を傾斜させ通常の電子顕微鏡観察を すればよく、観察用の試料作製と観察とが同一の真空槽

2

[0004]

内で連続して行える。

【作用】電子ピーム励起ドライエッチングは被加工物表 面に形成した反応ガスの吸着層に電子線を照射して化学 反応を促進し、加工物表面原子を反応ガスとの揮発性反 応生成物として取り除く加工方法である。 図3は、この 機構を示す説明図で、まず図3(a)に示すように、被 加工物303の表面に反応ガス吸着層301が形成され る。次いで図3 (b) で電子ピーム304を照射するこ とで吸着された反応ガスが被加工物303の表面原子3 02と化学反応を起こし、図3(c)のように揮発性反 応生成物305となって除去されることにより、加工が 行われる。本加工法は電子ビーム励起による化学反応を 20 利用しているため、電子線照射領域を走査することで任 意の部分の異方性エッチングを低損傷で実現できる。

【0005】次に、本発明の方法である電子ピーム励起 ドライエッチングを利用した微細構造の断面観察の手順 を図1に示す。基板102に微細パターン103が形成 された試料を走査型電子顕微鏡観察の場合と同様に試料 ホルダにセットし、真空排気する。十分に高真空を得て から、図1 (a) に示すように、基板材料と揮発性の化 合物を形成するような反応ガスを試料室に導入すると共 に電子ピーム101を照射して、電子ピーム励起ドライ エッチングにより観察したい部分の断面が現れるように 試料の一部分を除去する。図1(b)に示すように観察 試料を加工した後、反応ガスの導入を停止して試料室の 排気を継続する。真空度が回復した後、図1(c)に示 すように試料を傾斜させて通常の走査型電子顕微鏡観察 を行うことで微細構造試料の断面観察が可能である。本 方法は測定室で観察用の試料を簡単に作製できるだけで なく、一度観察した試料を再びエッチングすることで、 新たに別の部分の断面を観察できるという利点を持つ。 本発明の装置によれば、走査型電子顕微鏡にガス導入機 40 構を増設することで、電子ピーム励起ドライエッチング 機能が付加され、微細構造の断面観察用試料の作製と観 察が同一真空槽内で可能となる。また、試料を任意の傾 斜で保持する試料台を備えることにより、所望の箇所の 電子顕微鏡観察を容易に行うことができる.

[0006]

【実施例】次に本発明の実施例について説明する。本実 施例では、シリコン基板上に形成されたレジストパター ンの断面観察を、反応ガスにCIFaガスを用いた電子 ビーム励起ドライエッチングによって実施した例を詳細 任意の傾斜方向および傾斜角度で保持する試料台とを付 50 に説明する。本発明の実施に際しては、通常の走査型電 子顕微鏡を改造した図2のような装置を用いて行った。本装置は、走査型電子顕微鏡観察用の試料室206にガス導入機構を備えたものであり、ガス導入機構は、反応ガス212を収納するガス収納室213と、ガス導入弁211とからなる。真空排気系は反応性のガスの導入に際しても電子線照射が安定して行えるよう大排気量の差動排気システムを採用すると共に、真空ポンプには反応性のガスにも耐性のあるケミカル仕様のターボ分子ポンプ208を用いている。また、試料209を保持する試料台210は、±90°の傾斜が可能である。なお図 10中、201は電子銃電源・制御系、202は電子銃、203はコンデンサレンズ、204は偏向コイル、205は対物レンズ、207はロータリーポンプである。

【0007】断面観察はSi基板上に電子ピーム露光に より形成した線幅0. 1μmのPMMAレジストのライ ンパターンについて行った。試料を基板ホルダにセット して真空排気し、通常の走査型電子顕微鏡(SEM)観 察にて表面の微細構造を評価し、断面観察を行う領域な らびにそのために除去すべき部分を決定した。次に電子 線の走査範囲を除去すべき領域に合わせたままで、反応 20 ガスであるC1Faガスを試料室に導入し、ガス分圧を 2×10-5 Torrとした。この操作により試料表面に 吸着したClF。はPMMAレジストならびにSI基板 と化学反応を起こし、揮発性の反応生成物を形成する結 果、エッチング(電子ビーム励起ドライエッチング)が 進行して試料の一部が除去できる。その後、電子線の照 射ならびに反応ガスの供給を停止し、排気を継続する。 真空度が回復してからSEM観察を再開し、観察すべき 断面が現れるように試料を傾斜させてレジストパターン の断面観察を行った。SEM観察に際して試料表面のレ 30 ジストによるチャージアップの影響を軽減するため、電 子線の加速電圧を1keVに下げて観察した。また、反 応ガスを観察する材料に応じて選ぶことで、種々の試料 についての断面微細構造の観察が可能である(Cl2, XeFiなど)。さらに、上記のSi基板上のPMMA レジストの微細構造観察の実施例において、反応ガスと してO₁ガスを用いると、S₁基板上のレジストのみを 除去することが可能である。

[0008]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば従来の方法では不可能であった任意の微小領域の断面観察が簡単に出来るだけでなく、通常のSEM観察と断面観察用試料の作製が連続して繰り返し行えるという利点を持つ。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の方法による断面観察の手順を示す工程 図である。

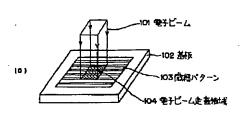
[図2] 本発明による断面微細構造観察装置の一例の構成図である。

[図3] 電子ピーム励起ドライエッチングのエッチング 機構を示す説明図である。

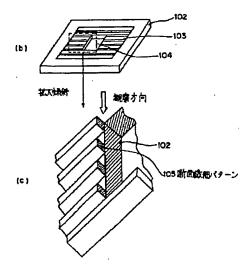
【図4】従来例による断面観察試料の作製の方法を示す 工程図である。

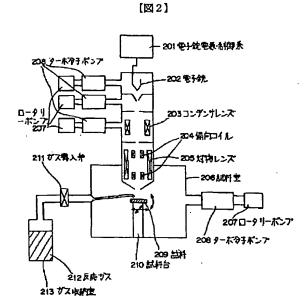
【符号の説明】

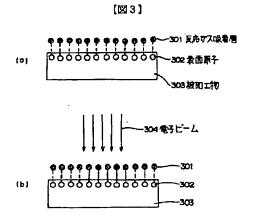
	101,	304 電子ピーム	102,	401
	基板			
	103	微細パターン	104	電子ビ
	一ム走査	領域		
	105	断面微細パターン	201	電子銃
電源・制御系				
	202	電子銃	203	コンデ
	ンサレン	ズ		
	204	偏向コイル	205	対物レ
	ンズ			
	206	試料室	207	ロータ
	リーポン	/プ		
	208	ターポ分子ポンプ	209	試料
	2 1 0	試料台	211	ガス導
	入弁			
1	212	反応ガス	213	ガス収
	納室			
	301	反応ガス吸着層	302	表面原
	子			
	303	被加工物	305	揮発性
	反応生成	支物 .		
	403	微細パターン	404	へき開
面				
	405	はく離	406	破壞
	407	変形		

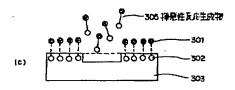


[図1]









[図4]

